

11月市场洞察报告

半导体市场分析与趋势展望

“DISTINCTIVE
INSIGHTS,
INFORMED
DECISION-MAKING”

洞察行情 精准决策

序言

本报告由安芯易电子商务（深圳）有限公司推出，旨在为客户、供应商及合作伙伴提供半导体行业资讯及市场趋势预测，报告涵盖宏观动态、半导体产业动态、终端市场动态、重点产品行情等模块，助力行情洞察、精准决策。

本报告每月更新，可关注安芯易电子微信公众号，及时获取报告发布等信息。您也可以通过联系安芯易客户经理获取完整版报告。

目录

摘要 4

一、宏观动态 5

 (一) 行业政策 5

 (二) 经济指数 6

二、半导体产业动态 11

 (一) 短期影响 12

 (二) 中期影响 14

 (三) 长期影响 16

三、终端市场动态 19

 (一) 人工智能 20

 (二) 新能源 21

 (三) 消费电子 21

 (四) 工业电子 22

 (五) 汽车电子 22

 (六) 通信电子 23

 (七) 医疗电子 23

四、重点产品行情 24

 (一) 存储芯片 24

 (二) GPU 26

 (三) MCU 28

信息来源 30

免责声明 34

摘要

2025 年 11 月重点行情趋势	
宏观动态	● 中国/欧盟：中欧敦促安世半导体内部协商，控制权僵局待解 ● 美国：考虑批准英伟达 H200 芯片对华出口，同步推进中东 AI 合作 ● 欧盟：批准 4.5 亿欧元补贴安森美半导体扩建芯片厂 ● 日本：千亿日元投入 2nm 工艺量产，确立半导体为国家战略核心 ● 中国台湾：更新出口管制清单，新增 18 项高科技货品
产业动态	短期影响 ● 美光：HBM 产能全面告罄，自主基片策略与明确出货时间表凸显短期供应链瓶颈 ● SK 海力士：DRAM/NAND 合约价全面上调，AI 存储战略地位持续强化 ● 三星：引领存储芯片超级周期，DDR5 合约价暴涨 60%冲击供应链 ● 超威半导体：Q3 业绩显著增长，高管减持引关注 ● 超微：推出全栈 AI 解决方案，简化算力部署 中期影响 ● 松下：钽电容价格上调 15%-30%，AI 服务器需求推动行业性涨价 ● 亚德诺半导体：实施两阶段调价，模拟芯片加入涨价序列 ● 中芯国际：业绩与产能利用率齐升，夯实中期增长基石 ● Arm 安谋：业绩与生态同步跃升，确立 AI 计算中期核心地位 ● 施耐德电气：获 23 亿美元数据中心订单，供电与冷却系统首次进入“产能锁定”阶段 ● 忆联：推出液冷 SSD，助力实现服务器全域液冷新突破 长期影响 ● 英伟达：Blackwell 芯片全面量产，获中东 3.5 万颗芯片出口许可 ● 长鑫存储：首次全面展示 DDR5 与 LPDDR5X 新品 ● 三星：激进扩张 1c 纳米 DRAM 产能，锁定长期技术主导权 ● 鸿海：斥巨资建设超算中心，奠定长期 AI 服务基石 ● 台积电：Blackwell 实现“美国制造”，2nm 产能持续扩张
终端市场	● 人工智能：特斯拉宣布 AI5 芯片设计即将完成，AI6 芯片研发启动；谷歌全面导入搜寻引擎 AI 模型 Gemini 3；英伟达微软携手豪掷 150 亿美元投资 Anthropic；微软投资逾 150 亿美元于阿联酋扩建 AI 数据中心。 ● 新能源：汇川技术 50GW 储能基地正式投产；纯电动保时捷卡宴官图发布，最大功率超 1000 马力。 ● 消费电子：荣耀 500 系列发布，搭载汇顶科技多项产品；阿里旗下夸克 AI 眼镜将举行新品发布会。 ● 工业电子：博雷顿发布全球首款无人驾驶专用矿卡；霍尼韦尔在进博会发布八款新品，覆盖工业燃烧、工业自动化领域。

	● 汽车电子：北汽华为联手打造新款享界 S9 上市；零跑汽车 A10 广州车展全球首秀。 ● 通信电子：博通推出全球首款量子安全第八代 128G SAN 交换机产品组合；中兴与印尼 XLSMART 合作完成 FDD Massive MIMO AAU 产品；诺基亚与日本 NTT DOCOMO 部署 MantaRay SON 革新 5G 运营。 ● 医疗电子：GE 医疗 23 亿美元收购 Intelrad，加速布局云端与 AI 生态。
产品行情	● 存储芯片：存储现货市场急单需求形成动力支撑，存储成品端价格继续上探 ● GPU：GPU 需求激增，但高端产品供应持续紧张 ● MCU：车规 MCU 供不应求，本土供应链发展加速

一、宏观动态

（一）行业政策

● 中国/欧盟：中欧敦促安世半导体内部协商，控制权僵局待解

荷兰政府于 2025 年 11 月 19 日宣布暂停对安世半导体（Nexperia）的行政干预措施。在此背景下，中国商务部与欧盟委员会于 11 月 26 日举行视频会谈，双方一致认为企业是解决安世半导体问题的主体，并共同敦促"安世荷兰"与"安世中国"尽快开展建设性沟通，以寻求长期解决方案，恢复全球半导体供应链的畅通与稳定。

尽管荷兰方面暂停了行政令，但根本问题尚未解决。荷兰企业法庭于 10 月 7 日作出的裁决仍然有效，包括暂停闻泰科技创始人张学政的职务，以及将安世半导体股份托管给指定人员等。这意味着闻泰科技对安世半导体的控制权仍处于受限状态。中方明确指出，荷兰的行政干预"仍未取消"，是全球半导体供应链面临较大不确定性的根源。这一事件凸显了地缘政治因素对全球半导体产业链的深远影响，后续进展将取决于荷方能否进一步撤销干预，以及安世荷兰与安世中国之间能否实现有效对话。

● 美国：考虑批准英伟达 H200 芯片对华出口，同步推进中东 AI 合作

2025 年 11 月，美国政府在人工智能芯片出口政策上出现关键动向。一方面，美国商务部正在重新审查其出口管制政策，考虑批准英伟达向中国出售其 H200 人工智能芯片。另一方面，商务部已正式授权向阿拉伯联合酋长国的 G42 和沙特阿拉伯的 Humain 公司出口最多相当于 35,000 颗英伟达 Blackwell 架构 GB300 芯片。

对华出口许可的考虑，反映了在美中关系出现缓和的背景下，美国政府内部关于技术限制与市场利益之间的权衡。美国商务部长霍华德·卢特尼克指出，此类决定最终将由总统特朗普亲自作出。值得注意的是，H200 芯片的性能据估计约为目前已获对华出口许可的 H20 芯片的两倍，此举若成行，

将显著提升英伟达在中国AI芯片市场的竞争力。与此同时，对中东的出口批准则基于严格的安全与报告规定，旨在推动美国与两国的人工智能合作，符合其全球AI领导力战略。这两项动态共同勾勒出美国半导体出口政策的新轮廓：在关键盟友区域深化技术绑定以巩固联盟，同时在战略竞争市场寻求有限度的、可控的技术出口，以平衡国家安全与经济利益。

- **欧盟：批准 4.5 亿欧元补贴安森美半导体扩建芯片厂**

欧盟委员会 11 月 19 日批准了捷克政府向美国芯片厂商安森美半导体提供 4.5 亿欧元国家补贴，用于在捷克建设碳化硅功率半导体生产线。欧盟表示，该项目符合欧洲芯片法的目标，将增强欧盟在关键半导体技术领域的自主能力，并提升绿色能源等领域所需先进芯片的供应安全。预计该项目投产后将加强欧盟在全球先进功率电子市场中的地位。

- **日本：千亿日元投入 2nm 工艺量产，确立半导体为国家战略核心**

日本经济产业省于 11 月 21 日宣布，通过信息技术促进机构向半导体企业 Rapidus 投入 1000 亿日元（约 47.8 亿元人民币），目标在 2027 财年下半年实现 2 纳米制程芯片的量产，并规划此后每 2-3 年迭代至 1.4 纳米等更先进技术。Rapidus 计划于 2029 财年实现正营运现金流，2031 财年实现上市。同时，日本政府在成长战略总部首次会议中将“AI 与半导体”列为 17 个战略领域之首，通过官民协同、技术标准化与人才培养，全面强化本土半导体供应链。此举旨在突破日本在先进制程领域的对外依赖，重塑其全球半导体产业竞争力。

- **中国台湾：更新出口管制清单，新增 18 项高科技货品**

11 月 17 日，中国台湾省经济部国际贸易署预告修正出口管制清单，新增高阶 3D 打印设备、先进半导体设备、量子电脑三大类共 18 项管制项目。其中先进半导体设备涵盖互补金属氧化物半导体集成电路、EUV 光罩、低温冷却系统、扫描电子显微镜设备等关键项目。

此次修正旨在与瓦圣那协议等国际出口管制规范接轨，属于例行调整。值得注意的是，管制并非禁止出口，而是要求厂商出口前需申办输出许可证，经审核无武器扩散风险后即可放行。此举有助于中国台湾地区维持在全球高科技供应链中的合规性与可信度，对合法商业贸易影响有限，但将促使相关企业加强出口合规管理。

（二）经济指数

- **10 月全球制造业 PMI 维持在 50.8，复苏动能温和且呈现结构性不均衡**

2025 年 10 月，全球制造业采购经理人指数（PMI）为 50.8，连续三个月维持在扩张区间，创下近三年同期较高水平。然而，增长动能依然疲弱，新订单与产出的温和增长未能阻止积压订单下降，也未能带动就业水平显著提升。同时，商业信心指数降至近三年低点，预示未来数月制造业面临显

著下行风险。

主要经济体表现呈现明显分化：美国制造业 PMI 为 52.5，在关税政策推高输入成本的背景下保持相对强劲扩张；印度以 59.2 的亮眼数据领跑全球；中国制造业 PMI 为 50.6，连续三个月处于扩张区间但增速有所放缓；而日本（48.2）与韩国（49.4）则持续处于收缩区间，反映亚洲制造业复苏不均衡。

对半导体产业的影响：当前全球制造业“低速扩张+弱需求+结构分化”的态势意味着下游电子、消费电子、工业电子等领域需求将保持谨慎增长。半导体产业链各环节参与者需重点关注区域经济差异、订单波动与库存调整，通过灵活的供应链管理和客户结构优化，应对潜在的市场不确定性。

全球各地区制造业 PMI

时间	全球	中国	日本	韩国	印度	美国	欧元区
2023-11	49.30	49.40	48.30	50.00	56.00	46.70	44.20
2023-12	49.00	49.00	47.90	49.90	54.90	47.40	44.40
2024-01	50.00	49.20	48.00	51.20	56.50	49.10	46.60
2024-02	50.30	49.10	47.20	50.70	56.90	47.80	46.50
2024-03	50.60	50.80	48.20	49.80	59.10	50.30	46.10
2024-04	50.30	50.40	49.60	49.40	58.80	49.20	45.70
2024-05	50.90	49.50	50.40	51.60	57.50	48.70	47.30
2024-06	49.50	49.50	50.00	52.00	58.30	51.70	45.60
2024-07	49.80	49.40	49.10	51.40	58.10	46.80	45.80
2024-08	48.90	49.10	49.80	51.90	57.50	47.20	45.60
2024-09	48.80	49.80	49.70	48.30	56.50	47.20	45.00
2024-10	48.80	50.10	49.80	48.30	57.50	46.50	46.00
2024-11	50.00	50.30	49.00	50.60	56.50	48.40	45.20
2024-12	49.60	50.10	49.60	49.00	56.40	49.20	45.10
2025-1	50.10	49.10	48.70	50.30	57.70	50.90	46.60
2025-2	50.60	50.20	49.00	49.90	56.30	50.30	47.60
2025-3	50.30	50.50	48.40	49.10	58.10	49.00	48.60
2025-4	49.80	49.00	48.70	47.50	58.20	48.70	49.00
2025-5	49.60	49.50	49.40	47.70	57.60	48.50	49.50
2025-6	50.30	49.70	50.10	48.70	58.40	49.00	50.50
2025-7	49.70	49.30	49.90	48.00	59.20	48.00	49.80
2025-8	50.90	50.50	52.00	48.30	59.30	53.00	50.70
2025-9	50.70	51.20	48.50	50.70	57.70	52.00	49.80
2025-10	50.80	50.60	48.20	49.40	59.20	52.50	50.00

数据来源：Wind

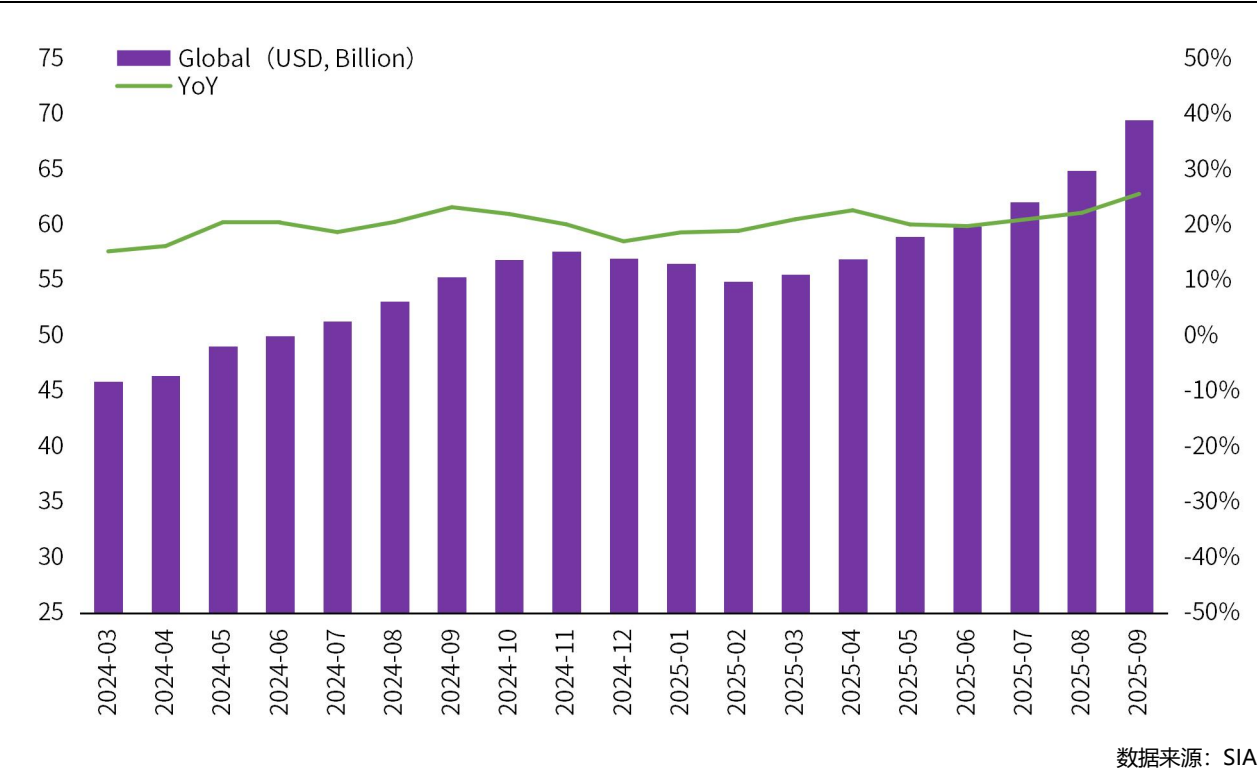
● 全球半导体销售延续强劲增长，第三季度环比增长 15.8%至 2084 亿美元

2025 年第三季度全球半导体销售额达到 2084 亿美元，环比第二季度大幅增长 15.8%，创下近期增长新高。单月表现尤为亮眼，9 月全球销售额为 695 亿美元，较 2024 年同期增长 25.1%，环比 8 月增长 7.0%，显示市场已全面走出库存调整周期。

区域表现呈现显著分化，亚太与美洲引领增长：从区域市场看，增长动能高度集中：亚太及其他地区（不含中日）9 月销售额同比激增 47.9%，环比增长 8.2%；美洲市场同比增长 30.6%，环比增长 8.0%；中国市场保持稳健，同比增长 15.0%；而日本市场是主要区域中唯一表现疲软的，同比下降 10.2%。这种区域分化格局表明当前半导体市场的复苏具有明显的不均衡性。

存储与逻辑芯片成为核心驱动力，新兴应用注入持续动能：需求侧方面，存储器和逻辑芯片成为本轮增长的核心驱动力，云计算、AI 基础设施及智能驾驶等新兴应用的需求持续释放。基于当前强劲增长态势，世界半导体贸易统计组织（WSTS）维持对 2025 年全球半导体市场的乐观预期，预计全年销售额将达 6972 亿美元，同比增长 11.2%。尽管短期增长显著，产业链各环节仍需警惕年底需求回落、库存调整及地缘政治风险对复苏持续性的潜在影响。

全球半导体销售额（十亿美元）



● 美国十年期国债收益率跌破 4%关键点位，市场降息预期显著升温

2025 年 11 月，美国十年期国债收益率呈现显著下行态势，于 11 月下旬一度跌破 4% 的关键心理关口，下探至 3.994%，创下自 10 月底美联储议息会议以来的新低。这一重要技术点位的突破，

反映了债券市场对货币政策前景的重新定价。

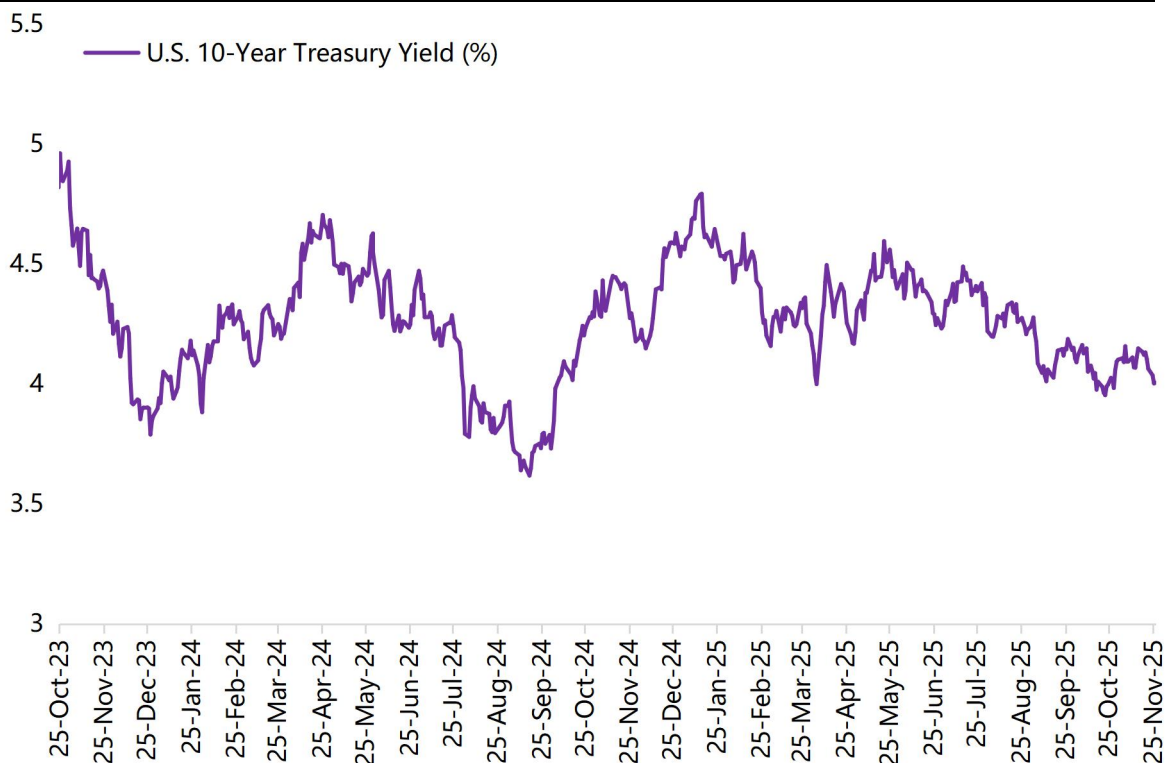
经济数据持续走弱为收益率下行提供了基本面支撑：就业市场显现疲软迹象，ADP 数据显示私营部门就业人数连续减少；消费者信心指数滑落至 88.7，创七个月新低。与此同时，政策预期变化成为关键推动力，新任美联储主席人选凯文·哈塞特被市场视为宽松政策的倡导者，强化了市场对近期开启降息周期的预期。

从期限结构看，各期限收益率同步下行，2 年期收益率降至 3.46%，5 年期收益率降至 3.57%，短端收益率降幅更为显著，反映出市场对美联储近期降息的预期持续强化。收益率曲线的陡峭化趋势进一步印证了市场对宽松货币政策前景的定价。

对半导体等资本密集型产业而言，十年期国债收益率跌破 4% 意味着融资成本有望降低，为企业扩产与研发投入提供了更有利的金融环境。特别是在全球半导体市场复苏周期中，融资条件的改善将直接支持产能扩张与技术升级计划。

尽管收益率已跌破关键点位，但未来走势仍取决于经济基本面与政策信号的进一步明确。市场将密切关注 12 月美联储议息会议提供的政策路径指引，任何经济数据回暖或政策预期逆转都可能引发收益率重新走高，潜在波动风险仍需警惕。

美国 10 年期国债利率(%)



数据来源：Investing

● 费城半导体指数 10-11 月走势分析：高位震荡与结构性调整主导市场表现

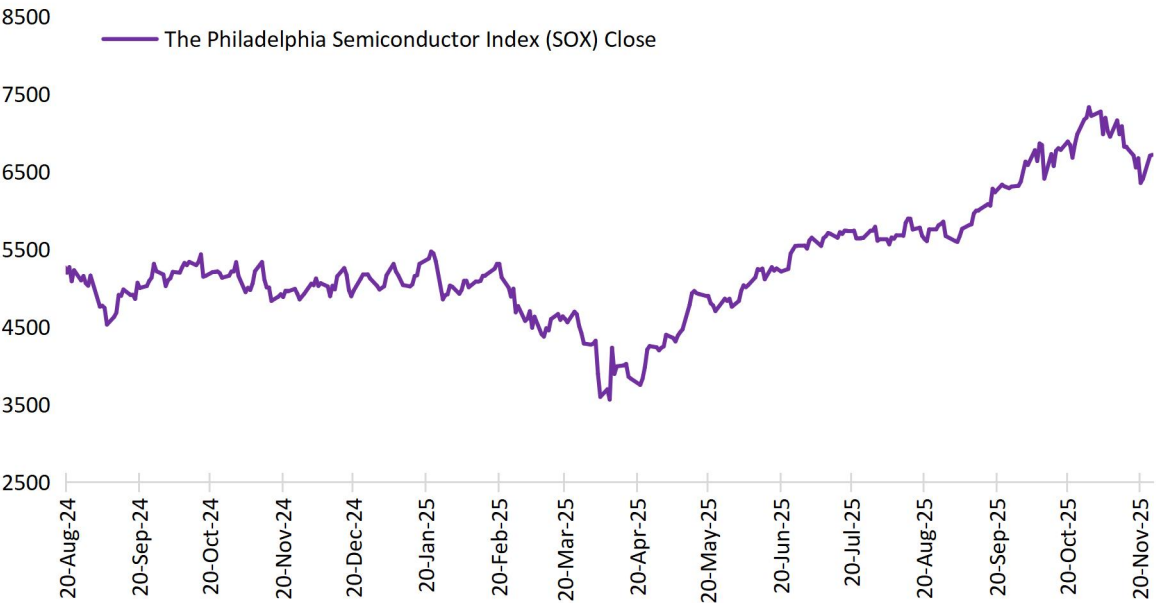
2025 年 10-11 月，费城半导体指数呈现明显的高位震荡与结构性调整特征。10 月份指数在 4700-5100 点区间维持震荡格局，受 AI 芯片需求与消费电子疲软的双重因素影响，形成多空拉锯态势。尽管 AI 芯片龙头厂商受云计算投资支撑保持相对强势，但智能手机等传统消费电子领域复苏缓慢制约了指数的上行空间，使得指数在关键技术位间反复震荡。

进入 11 月后，市场环境发生显著变化，指数经历深度回调。截至 11 月 21 日，指数月内跌幅达 3.92%，最低下探至 6406.43 点，创下近期新低。此轮调整主要受宏观经济担忧与板块资金轮动影响，美国劳动力数据疲软引发市场对半导体需求放缓的忧虑，投资者从高估值科技股转向防御性板块。值得关注的是，存储芯片领域逆势走强，DRAM 价格月内飙升 77.40%，成为市场中的突出亮点。

11 月下旬，指数迎来强劲反弹。11 月 24 日单日涨幅达 4.63%，收于 6703.20 点，此轮反弹主要受益于货币政策预期转向与细分领域景气度回升。市场对美联储降息的预期显著升温，特别是伴随哈塞特可能出任美联储主席的传闻，推动科技股估值修复。同时，AI 概念股重获资金流入，英伟达、台积电等权重股止跌回升，与存储芯片价格上涨形成合力，共同推动指数反弹。

总体而言，10-11 月费城半导体指数的波动走势反映了全球半导体产业正处于结构性调整阶段，AI 创新与传统需求疲软之间的拉锯成为影响市场表现的关键因素。随着货币政策预期转变与细分领域景气度分化，半导体板块预计将在四季度余下时间继续保持结构性行情特征，投资者需重点关注 AI 算力、存储芯片等具有核心竞争优势的细分领域。

费城半导体指数(SOX)



数据来源：MacroMicro

二、半导体产业动态

半导体产业动态概览			
维度	厂商	经营动态	解读
短期影响	美光 Micron	2025 年 HBM3E 与 HBM4 产能已全部售罄，HBM4 将于 2026 年 Q2 出货。	产能被提前锁定，预示 AI 内存供需紧张关系将在未来 1-2 年内持续。
	SK 海力士 SK Hynix	预计第四季度 DRAM 平均售价(ASP)将环比上涨至“高个位数上缘”，涨幅超最初预期。	与三星共同主导的涨价潮，将立即改善其现金流与盈利能力。
	三星 Samsung	11 月将部分存储芯片价格较 9 月上调高达 60%，32GB DDR5 模组从 149 美元涨至 239 美元。	大幅涨价直接推高 AI 服务器等硬件成本，加剧下游厂商的供应压力和恐慌性采购。
	超威半导体 AMD	2025 年 Q3 营收 92 亿美元，净利润同比 +61%；完成 AI 推理团队 MK1 收购；预计数据中心业务五年内年营收突破 1000 亿美元。	创纪录的业绩与战略性收购，直接增强了其在高性能计算与 AI 推理领域的即时竞争力，为下一阶段增长提供短期动能。
	超微 Supermicro	在 SC25 大会上展示集成 NVIDIA GB300 NVL72 的机柜级液冷解决方案，以及一系列针对 HPC 和 AI 工作负载优化的服务器平台。	为市场提供了即插即用的高端 AI 算力解决方案，能直接满足下游厂商对 AI 基础设施的紧迫需求。
中期影响	松下 Panasonic	11 月向代理商与直接客户发出涨价通知，对部分规格的钽质电容产品价格上调 15%至 30%，新价格将于 2026 年 2 月 1 日生效	日系厂商加入涨价行列，印证了 AI 服务器对钽电容的需求已超出当前供应链承载能力，供需紧张关系预计在未来 1-2 个季度内持续。
	亚德诺半导体 ADI	计划于 2026 年 2 月 1 日调整部分产品价格，涨幅分为 15% 和 30% 两档，预计将在 12 月中旬开始向客户发放正式涨价函	模拟芯片大厂的调价行动，表明 AI 驱动的高端元件成本压力正在向更广泛的半导体产业链传递，将影响未来多个季度的采购策略与成本结构。
	中芯国际 SMIC	2025 年 Q3 营收与净利润创单季新高，归母净利润同比+43.1%；产能利用率 95.8%，12 英寸晶圆营收占比 77%。	强劲的业绩与接近满负荷的产能，标志着其成熟与特色工艺平台的竞争力进入新阶段，为其中期发展提供了明确的增长动能。
	安谋 Arm	2026 财年 Q2 营收 11.4 亿美元，净利润 +122%；累计签署 19 项 CSS 授权协议；预计其架构在数据中心 CPU 市场份额将达 50%	强劲的业绩与生态扩张，确立了 Arm 在 AI 计算时代的核心地位，其中期增长将由数据中心渗透与高价值 CSS 产品驱动。
	施耐德电气 Schneider Electric	Switch、Digital Realty 等签署总额 23 亿美元的数据中心关键基础设施合同，并采用产能锁定模式。	标志着 AI 数据中心基础设施供需关系发生根本转变，供电与冷却系统首次进入“产能预定”阶段，具备一体化解决方案能力的厂商将在未来 1-2 年获得显著竞争优势。

	忆联 Union Memory	与英特尔、新华三等合作伙伴联合发布双路冷板式全域液冷服务器，其中忆联提供液冷 SSD 组件。	反映了为应对 AI 算力功耗和散热挑战，数据中心基础设施正朝着液冷化、协同优化的方向快速发展。
长期影响	英伟达 NVIDIA	季度总营收达 570 亿美元，并实现 Blackwell 芯片全面量产；同时发布下一代 Vera Rubin 技术路线图，获得向中东出口 3.5 万颗芯片许可，对华特供 H20 芯片销售不及预期。	通过超前技术布局与市场多元化战略，在定义 AI 算力发展标准的同时构建竞争壁垒，确保其在全球高端加速器市场的持续主导地位。
	长鑫存储 CXMT	在 IC China 2025 首次全面展示 DDR5 和 LPDDR5X 新品，最高速率分别达 8000Mbps 和 10667Mbps，覆盖全场景模组。	标志着中国存储芯片厂商正式具备了在高端市场参与国际竞争的潜力，将长期影响全球 DRAM 产业的供给格局和竞争态势。
	三星 Samsung	计划大幅扩充 1c 纳米 DRAM 产能，目标 2026 年 Q4 月产能达 20 万片晶圆，为下一代 HBM4 布局。	此举将重塑其在高端 DRAM 领域的竞争力，并深度影响未来全球 HBM4 市场的供给格局与技术路线。
	鸿海 Foxconn	宣布斥资 14 亿美元在台建设 27 兆瓦 GB300 超算中心，预计 2026 年上半年启用；超算中心约 70-80%算力已分配。	此举将奠定其在亚太 AI 基础设施领域的核心地位，并深刻影响区域 AI 算力服务的商业模式与产业生态。
	台积电 TSMC	计划在中国台湾再建三座 2 纳米制程晶圆厂，总投资额预估约 9000 亿新台币。	大规模的尖端制程投资，将长期巩固其在全球半导体制造领域的绝对领先地位和供应链核心节点价值。

(一) 短期影响

● 美光：HBM 产能全面告罄，自主基片策略与明确出货时间表凸显短期供应链瓶颈

美光高管近期确认，其 2025 年度的 HBM3E 与 HBM4 高带宽内存产能已全部售罄，并明确 HBM4 将于明年第二季度开始出货。这一动态不仅印证了 AI 算力需求持续爆发对高端存储供应链造成的巨大压力，更因美光在 HBM4 基片（base die）上选择的自主设计与生产策略而备受关注。尽管其竞争对手依赖台积电或三星代工基片，美光出于对内存特性的深度优化及去年代工厂方案未就绪的考量，决定自行掌控关键工艺，并预计此举将配合“沿用 HBM3E 流程”的开发策略，助力 HBM4 更快达成成熟良率、优化成本。

从短期影响来看，产能售罄与明确的出货时间表，为市场提供了确定性，但也凸显了供给瓶颈的刚性。AI 服务器厂商与云服务商在短期内将围绕有限的 HBM4 产能展开激烈争夺，交付压力与成本压力难以缓解。中期而言，若美光能凭借其自主生产策略实现良率的快速爬升和成本优化，将有望在 HBM4 这一代产品中扩大市场份额、增强盈利能力，并影响全球 HBM 市场的竞争格局。而长期看，其宣布从 HBM4E 开始将基片交由

台积电生产，则揭示了在更先进节点上，产业分工与合作模式可能再次发生演变。

● SK 海力士：DRAM/NAND 合约价全面上调，AI 存储战略地位持续强化

SK 海力士在 2025 年 10-11 月期间主导了新一轮存储芯片价格调整，预计第四季度 DRAM 平均售价将环比上涨至“高个位数上缘”，涨幅超出最初预期，同时 NAND 合约价也同步上调。这一价格变动反映了当前存储市场的根本性转变：AI 加速器、数据中心及高性能计算对高带宽内存的需求持续攀升，促使 SK 海力士将有限产能优先分配给高附加值的 HBM 产品，导致通用 DRAM/NAND 供应受到显著挤压。

在供不应求与高端存储优先供应的市场环境下，SK 海力士凭借其在 HBM 领域的领先地位维持了较强的议价能力与毛利率水平。随着 HBM 及高性能 DRAM 市场份额的持续提升，公司在 AI 与数据中心存储供应链中的战略地位得到进一步巩固。这一系列变化不仅将直接改善公司的营收结构与盈利能力，也意味着传统 DRAM/NAND 在消费电子领域的供应将持续紧张，存储产业链的价值分配正迎来深刻重构。

● 三星：引领存储芯片超级周期，DDR5 合约价暴涨 60%冲击供应链

三星电子在 2025 年 11 月对存储芯片价格进行重大调整，其中 32GB DDR5 模组合约报价从 9 月的约 149 美元大幅上调至约 239 美元，涨幅高达 60%，此举标志着全球存储市场正式进入“存储芯片超级周期”。这一价格调整直接源于 AI、大型数据中心扩容和云基础设施建设的强劲需求，促使三星将主要产能优先分配给利润更高的 HBM 产品，导致通用 DRAM 供应严重受限。

此次大幅涨价充分体现了三星在全球存储市场的定价权与供应链控制力。从短期影响来看，三星存储业务的毛利率与现金流将获得显著改善；然而对下游终端设备厂商而言，存储成本的大幅上涨将不可避免地转嫁至产品售价，或直接压缩厂商利润空间，甚至可能抑制中低端产品的市场需求。在供应不确定性加剧的背景下，部分客户已接受高出 50% 以上的价格涨幅，并采取恐慌性采购策略，这将进一步强化存储市场的卖方格局，对全球电子产品供应链产生立竿见影的冲击。长期来看，这一趋势将加速高端存储与企业级存储产品对传统消费级 DRAM/NAND 的替代进程，推动存储产业格局的深度重构。

● 超威半导体：Q3 业绩显著增长，高管减持引关注

2025 年 11 月，AMD 交出了一份亮眼的第三季度财报，营收达 92.46 亿美元，同比增长 36%，净利润实现 12.43 亿美元，同比大幅增长 61%。这一表现主要得益于客户端业务创下历史新高，以及数据中心业务持续走强。与此同时，AMD 完成了对 AI 推理团队 MK1 的战略收购，旨在整合其日均处理超 1 万亿 Token 的 Flywheel 引擎技术，增

强 Instinct GPU 在 AI 推理任务中的竞争力。然而，在公司业绩向好的背景下，包括首席技术官 Mark Papermaster 在内的多位高管在 11 月出现连续减持行为，虽属正常财务操作，但规模与集中度仍可能对短期市场情绪构成影响。

- **超微：推出全栈 AI 解决方案，简化算力部署**

超微在 11 月的 SC25 大会上展示了一系列创新的 AI 基础设施解决方案。其集成了 NVIDIA GB300 NVL72 的机柜级液冷解决方案，在单一机柜中整合了 72 个 Blackwell Ultra GPU 和 36 个 Grace CPU，采用直接液冷技术应对高功耗挑战。同时，公司发布了基于 AMD Instinct MI355X GPU 的 10U 风冷式 AI 服务器，为受限于基础设施改造的企业客户提供了灵活选择。尤为引人注目的是，超微推出了交钥匙“AI 工厂”集群解决方案，提供从 4 节点 32 个 GPU 到 32 节点 256 个 GPU 的不同规模配置，预装全套软件和线缆，实现即插即用，大幅简化了大规模 AI 算力设施的部署流程。

(二) 中期影响

- **松下：钽电容价格上调 15%-30%，AI 服务器需求推动行业性涨价**

松下在 2025 年 11 月正式宣布对部分规格钽电容产品实施价格调整，涨幅区间为 15% 至 30%，新价格计划于 2026 年 2 月 1 日正式生效。此次调价紧随全球钽电容龙头企业国巨旗下基美在 10 月底实施的第二次价格调整，后者涨幅同样达到 20%-30%。作为全球市场份额约 10% 的重要供应商，松下的价格调整标志着钽电容行业整体进入新一轮涨价周期。

本轮价格调整的主要推动力来自 AI 服务器市场的快速增长。GPU 服务器和 ASIC 服务器对电源系统稳定性的高要求，促使钽电容使用量显著增加。与此同时，钽金属原材料成本持续上升，加上行业供应链集中度较高，进一步加剧了市场供应紧张状况。考虑到产能扩张需要较长的周期，预计到 2026 年上半年，钽电容市场的供需关系仍将保持紧张态势。

- **亚德诺半导体：实施两阶段调价，模拟芯片加入涨价序列**

亚德诺半导体在 11 月宣布将于 2026 年 2 月 1 日起实施两阶段涨价，涨幅分别为 15% 和 30%，预计 12 月中旬开始向客户发放正式涨价函。作为模拟芯片领域的领导者，ADI 此次调价反映了在 AI 硬件需求激增的背景下，成本压力正从被动元件向更基础的模拟芯片领域蔓延。

这一系列价格调整意味着下游制造企业将在未来多个季度面临来自不同元器件类别的综合成本上升。各行业制造商需要相应调整其供应链管理和采购策略，以应对持续的成本结构变化。ADI 的价格政策在半导体行业具有重要影响力，此次调价预计将对 AI 硬件制造成本产生进一步的影响。

- **中芯国际：业绩与产能利用率齐升，夯实中期增长基石**

中芯国际在 11 月发布的 2025 年第三季度财报，其核心意义在于中期影响。营收与净利润双双创下历史新高，特别是 95.8% 的高产能利用率，直观地反映了其成熟制程和特色工艺平台在当前市场格局下的强劲需求与卓越的运营效率。12 英寸晶圆营收占比持续提升至 77%，以及工业与汽车等高价值领域收入的增长，表明其产品组合优化战略成效显著，盈利能力得到结构性改善。尽管对第四季度的指引趋于保守，但本季度的高效表现为其中期发展储备了充足的资本和信心。中长期看，这为其在先进封装、面板驱动、CIS 等优势领域的持续拓展，以及应对未来可能更激烈的市场竞争，奠定了坚实的财务与运营基础。

- **Arm 安谋：业绩与生态同步跃升，确立 AI 计算中期核心地位**

Arm 在 11 月发布的 2026 财年第二季度财报，其核心意义在于中期影响。营收连续三个季度突破 10 亿美元、净利润同比暴涨 122%，以及累计签署 19 项高价值 CSS 授权协议，共同印证了其商业模式升级的成功。更重要的是，其架构在数据中心的市场份额预计将接近 50%，这标志着 Arm 已从移动领域的王者，成功转型为 AI 与云计算基础设施中不可或缺的计算基石。中期来看，随着谷歌、微软、英伟达等巨头将其核心应用和未来订单构建于 Arm 架构之上，以及其向自研芯片领域的谨慎探索，Arm 的成长故事将从 IP 授权扩展至整个 AI 算力生态的深度参与，其增长动能和行业影响力在未来数个季度内将持续强化。

- **施耐德电气：获 23 亿美元数据中心订单，供电与冷却系统首次进入“产能锁定”阶段**

施耐德电气在 11 月与美国数据中心运营商 Switch 和 Digital Realty 分别签署了价值 19 亿美元和 3.73 亿美元的供电与冷却系统合同，总额达 23 亿美元。这些合同创新性地采用了“产能锁定”模式，标志着 AI 数据中心基础设施的供需关系发生根本转变——供电与冷却系统首次像先进芯片一样成为需要提前预定产能的紧缺资源。这一变化揭示了 AI 数据中心建设已进入快节奏、短周期的新阶段。施耐德能够赢得这些大单，关键在于其通过收购冷却厂商 Motivair 形成了“供电+冷却”的一体化解决方案能力。从产业

链角度看，这一订单预示着 AI 基础设施竞争要素的深刻变革：未来 1-2 年内，具备整体解决方案能力和快速交付优势的厂商将在市场竞争中获得决定性优势。

● 忆联：推出液冷 SSD，助力实现服务器全域液冷新突破

2025 年 11 月，忆联与英特尔、新华三等合作伙伴联合推出双路冷板式全域液冷服务器，其中忆联提供的液冷版 UH812a 企业级固态硬盘成为解决方案的关键组件。这一合作标志着数据中心散热技术从传统的 CPU 散热扩展至对内存、SSD 等所有关键热源的“全域”液冷覆盖。

随着算力密度提升，存储子系统已成为数据中心新的散热瓶颈。典型 24 盘位服务器的存储子系统功耗已突破 600 瓦，而企业级 NAND 闪存具有严格的 70°C 工作温度上限。忆联的液冷 SSD 通过优化结构设计，提供高达 25 瓦的单盘散热能力，精准满足 PCIe 5.0 企业级 SSD 的散热需求，确保设备在持续高负载下保持稳定性能。

这一技术突破基于忆联在控制器芯片、热管理算法等五个层级的全链路创新。该方案不仅解决了当前散热挑战，更为未来更高功耗存储设备做好准备，预计可支持 40 瓦乃至 70 瓦的散热需求。

从产业影响看，忆联的液冷方案将推动数据中心向绿色化发展，使 PUE 降至 1.1 以下，同时为 AI 训练等高性能计算场景提供可靠的数据存储基础。此次合作展现了忆联在细分领域的技术实力，通过生态协同占据“全域液冷”技术高地，成为推动数据中心基础设施升级的重要力量。

（三）长期影响

● 英伟达：Blackwell 芯片全面量产，获中东 3.5 万颗芯片出口许可

英伟达在 2025 年 11 月实现重要业务突破：首先，Blackwell 架构芯片进入全面量产阶段，推动公司第三财季营收达 570.1 亿美元，其中数据中心业务收入 512 亿美元，同比增长 62%。其次，公司获得美国商务部批准，可向沙特和阿联酋出口最多 3.5 万颗 Blackwell 芯片，订单价值预计超 10 亿美元。与此同时，专供中国市场的 H20 芯片表现不佳，本季度销售额仅 5000 万美元。

在技术布局方面，英伟达发布了下一代 Vera Rubin 超级芯片路线图，该芯片将集成 HBM4 显存，产品规划直达 2027 年。这一超前技术展示与 Blackwell 芯片的量产成果共同强化了英伟达在 AI 算力领域的领导地位。

从长期影响看，英伟达通过技术领先与市场多元化战略，正在构建持续的竞争优势。中

东市场的突破性进展有效对冲了中国市场的政策风险，而明确的技术路线图不仅为全球 AI 发展设定了标准，也为公司未来数年保持市场主导地位奠定了坚实基础。

- **长鑫存储：首次全面展示 DDR5 与 LPDDR5X 新品**

2025 年 11 月，长鑫存储在中国国际半导体展（IC China 2025）上正式发布其最新 DDR5 与 LPDDR5X 内存产品：DDR5 速率最高达 8000 Mbps、颗粒容量 24 Gb，同时覆盖包括 UDIMM、RDIMM、SO-DIMM 等多种模组；LPDDR5X 则达到最高 10667 Mbps，提供颗粒、芯片及模组等多种封装形态。

这一新品发布意义重大：一方面，它标志着国产存储器在性能与规格上已迈入国际主流水平 — 在 DRAM 速率、容量、模组多样性等维度与日韩 / 美厂竞争；另一方面，考虑到目前全球 memory / DRAM / 高带宽内存（HBM）供给紧张、需求因 AI 与数据中心而大幅上升，长鑫的加入为全球内存市场提供了新的供给来源，有可能缓解供需结构失衡、稳定价格与交付。若长鑫后续量产、交货顺利，也可能在全球存储市场占据一席 — 对产业链供应与分销体系来说，是一个值得关注的新变量。

- **三星：激进扩张 1c 纳米 DRAM 产能，锁定长期技术主导权**

三星在 11 月宣布了其 1c 纳米 DRAM 的激进扩产计划，目标是在 2026 年第四季度实现月产能 20 万片晶圆。这一产能规模将占据其总 DRAM 产能的近三分之一，甚至超过了其在 2022 年半导体景气高峰期的新增产能。该决策的核心在于其长期影响。这不仅是为了应对当前由 AI 驱动的 DRAM 全面缺货，更是为了给其下一代 HBM4 产品奠定充足的底层晶圆产能基础。三星意图通过掌握最先进的底层 DRAM 工艺，在决定未来 AI 算力胜负的 HBM4 战场上，重新夺回市场领导地位。长期来看，若此扩产计划顺利实现，将极大增强三星在高端存储市场的供给能力和技术话语权，并对以 SK 海力士为首的竞争格局形成强力冲击。

- **鸿海：斥巨资建设超算中心，奠定长期 AI 服务基石**

鸿海在 11 月宣布斥资 14 亿美元建设 27 兆瓦的 GB300 超算中心，其核心价值在于长期影响。这不仅是亚洲首座 GB300 数据中心，更关键的是，其高达 70%-80% 的算力在启用前已被分配完毕，这强有力地证明了市场对大规模、企业级 AI 算力的迫切需求。长期来看，鸿海通过其 “AI Factory” 的新模式，旨在让 AI 开发公司无需自建数据中心，从而专注于算法与模型创新。这种从根本上改变 AI 算力供给方式的战略，若成功落地，将长期赋能整个亚太地区的 AI 生态系统，推动鸿海自身从 “全球制造工厂” 向 “AI 驱动的基础设施与服务巨头” 转型，并深刻影响区域 AI 产业的竞争格局。

- **台积电：Blackwell 实现“美国制造”，2nm 产能持续扩张**

台积电在 11 月取得重大里程碑，其美国亚利桑那工厂完成了首片用于 AI 的 Blackwell 芯片晶圆的生产，标志着最先进的 AI 芯片首次实现“美国本土制造”。这一突破不仅有助于缓解地缘政治风险，也展示了台积电在全球供应链布局上的战略灵活性。与此同时，台积电继续加码先进制程投资，计划在中国台湾新建三座 2 纳米制程晶圆厂，总投资额预估约 9000 亿新台币。这些大规模的前瞻性投资将为其巩固在先进制程领域的绝对领先地位提供坚实基础，确保在未来几年内持续满足全球对 AI 算力的爆炸性需求。

三、终端市场动态

终端市场动态概览			
类别	版块	厂商	11 月市场动态
人工智能	AI 芯片	特斯拉 Tesla	特斯拉宣布 AI5 芯片设计即将完成，AI6 芯片研发启动
	云计算与大数据	谷歌 Google	谷歌全面导入搜寻引擎 AI 模型 Gemini 3
		英伟达&微软 Nvidia & Microsoft	英伟达微软携手豪掷 150 亿美元投资 Anthropic
		微软 Microsoft	微软投资逾 150 亿美元于阿联酋扩建 AI 数据中心
新能源	光伏/储能	汇川技术 Inovance	汇川技术 50GW 储能基地正式投产
	新能源汽车	大众 Volkswagen	纯电动保时捷卡宴官图发布，最大功率超 1000 马力
消费电子	智能手机	荣耀 HONOR	荣耀 500 系列发布，搭载汇顶科技多项产品
	智能穿戴	阿里巴巴 Alibaba	阿里旗下夸克 AI 眼镜将举行新品发布会
工业电子	工业自动化与控制	博雷顿 Breton	博雷顿发布全球首款无人驾驶专用矿卡
		霍尼韦尔 Honeywell	霍尼韦尔在进博会发布八款新品，覆盖工业燃烧、工业自动化领域
汽车电子	汽车产业链	北汽集团&华为 BAIC Group & Huawei	北汽华为联手打造新款享界 S9 上市
		零跑 Leapmotor	零跑汽车 A10 广州车展全球首秀
通信电子	通信网络	博通 Broadcom	博通推出全球首款量子安全第八代 128G SAN 交换机产品组合

		中兴 ZTE	中兴与印尼 XLSMART 合作完成 FDD Massive MIMO AAU 产品
		诺基亚 Nokia	诺基亚与日本 NTT DOCOMO 部署 MantaRay SON 革新 5G 运营
医疗电子	医疗设备	GE 医疗 GE HealthCare	GE 医疗 23 亿美元收购 Inteleraad, 加速布局云端与 AI 生态

（一）人工智能

- **特斯拉宣布 AI5 芯片设计即将完成, AI6 芯片研发启动**

特斯拉首席执行官马斯克日前在社交平台 X 上宣布, 特斯拉即将完成自研 AI5 芯片的设计定案, 同时已启动下一代 AI6 芯片的研发工作。AI5 芯片的设计评审已通过, 算力达 2000-2500 TOPS, 是目前 AI4 芯片的 5 倍, 具备支持复杂无监督自动驾驶算法的能力, 推理性能相比现有芯片提升约 50 倍。

- **谷歌全面导入搜寻引擎 AI 模型 Gemini 3, 正面迎战 OpenAI**

谷歌周二正式发布最新一代人工智慧模型 Gemini3, 抢攻生成式 AI 市场, 并迎战 ChatGPT 开发商 OpenAI。消息公布后, Alphabet 股价逆势上涨, 在近期 AI 类股的回调中展现抗跌力道。Gemini 3 是距离前一代仅 11 个月推出的版本。谷歌接连发布新一代大语言模型 Gemini3 和图像模型 Nano Banana Pro, 在通往 AGI 的道路上又迈出一大步。

- **英伟达、微软携手豪掷 150 亿美元投资 Anthropic**

微软与英伟达宣布将共同投资最多 150 亿美元至 AI 新创公司 Anthropic, 进一步强化全球 AI 运算版图。根据多家媒体报导, 这笔新资金使 Anthropic 的估值提升至约 3500 亿美元, 比九月募资后的 1830 亿美元大幅攀升。在最新协议中, 英伟达将投入最多 100 亿美元, 微软则承诺最多 50 亿美元。双方也将于 Anthropic 下一轮融资中参与投资, 以深化策略合作。

- **微软投资逾 150 亿美元于阿联酋扩建 AI 数据中心**

美国科技巨头微软周一宣布, 未来七年内 (至 2029 年底) 将在阿联酋 (UAE) 投资超过 150 亿美元, 主要用于扩建 AI 数据中心。此项重大投资已获得美国政府批准向阿联

酋出口高阶英伟达芯片。根据微软官方资料，截至今年底，公司在阿联酋的累计投资金额将达 73 亿美元，并计划于 2026 至 2029 年间再投入 79 亿美元，用于 AI 与云端基础设施的扩建。

（二）新能源

● 汇川技术 50GW 储能基地正式投产

11 月 17 日，汇川技术西安储能及电源系统制造基地在西咸新区沣东新城正式投产。首批智慧产线同步启用，年设计产能达 50GW，跻身全球储能 PCS 单体工厂第一梯队，标志着汇川数字能源能力的全面跃升，也为西安及西北地区绿色能源产业注入新动能。

● 纯电动保时捷卡宴官图发布，最大功率超 1000 马力

保时捷卡宴纯电版官图发布，新车基于 PPE 平台打造，采用 800V 架构，内外饰和现在比都有不小的变化，将于明年的北京车展在国内正式亮相。两款车型均搭载 113kWh 电池组，容量较 Macan 纯电版高出 13kWh。得益于 800 伏高压架构与优化的冷却系统，理想条件下充电峰值功率可达 400 kW，电量从 10% 充至 80% 仅需不到 16 分钟。值得一提的是，保时捷还首次在美国市场为量产电动车推出可选装无线感应充电技术：驶入车库，停于地面充电板上方，车辆即可自动启动最高 11 kW 的无线充电。

（三）消费电子

● 荣耀 500 系列发布，搭载汇顶科技多项产品

11 月 24 日晚，荣耀 500 系列发布，全系配备 2 亿像素主摄，其中 Pro 版额外搭载 5000 万像素夜景长焦镜头，支持 AI 助手 YOYO 一语暗光增强、一语贴纸合拍等。另据产业链人士透露，该机采用了汇顶科技多项产品，包括超声波光学指纹、智能音频放大器、触控以及 NFC+eSE 组合方案。

● 阿里旗下夸克 AI 眼镜将举行新品发布会

阿里巴巴首款自研旗舰双显 AI 眼镜——夸克 AI 眼镜 2025 年新品发布会定于 11 月 27 日举行。据悉，阿里旗下夸克 AI 眼镜与支付宝的合作再次升级，双方将在实现“看一下支付”的基础上，夸克 AI 眼镜新增准心辅助、骨传导拾音等独家能力。随着大厂陆续进入，AI 智能眼镜行业发展进入加速阶段。基于庞大的用户群体基础，智能眼镜有望成为下一个仅次于智能手机的消费电子大品类。

(四) 工业电子

● 博雷顿发布全球首款无人驾驶专用矿卡

11月21日，博雷顿在武汉工厂举办“无驾驶室纯电动矿卡下线仪式暨新车发布会”。此次发布会亮相了全球首款真正意义的无人驾驶专用矿卡，博雷顿 9M145E，搭载公司自研 E2E 智驾系统，新车采用无驾驶室设计，下线即具备投产状态，代表无人驾驶进入从“可做”到“真正投入生产”的新阶段。

● 霍尼韦尔在进博会发布八款新品

霍尼韦尔在进博会上推出八款新品，覆盖半导体、工业燃烧、工业自动化、智慧楼宇和电池安全五大关键领域，以精准响应中国市场需求。其中，面向半导体制造的新解决方案可提升晶圆制造的稳定性、精度和良率；ThermJet-pro 低氮氧燃烧器首次在中国亮相，兼顾高效燃烧与低排放；CCC Inside 与 Experion® PKS 集成方案则打造覆盖设备全生命周期的高性能控制平台。此外，霍尼韦尔还推出新型电池安全传感器，可在多种电池应用中提前预警热失控风险；面向未来的楼宇管理解决方案与 Optimizer 系列控制器也同步亮相，从软硬件层面提升建筑运营效率与智能化水平。

(五) 汽车电子

● 北汽华为联手打造新款享界 S9 上市

鸿蒙智行年度压轴新品——旗舰 9 系新款享界 S9 日前上市。新款享界 S9 实现六大升级，在豪华、智慧、驾控、安全等领域全维越境，有望开创豪华轿车新格局。据介绍，作为全面搭载华为旗舰顶配科技的旗舰 9 系车型，新款享界 S9 升级搭载了全新华为途灵平台、华为乾崮智驾 ADS 4、全新智慧电动门、全新星云尾灯、鸿蒙 ALPS 健康座舱、后排零重力座椅、华为百万像素智慧投影大灯、华为悦彰音响卓越系列等，引领豪华轿车价值跃迁。

● 零跑汽车 A10 广州车展全球首秀

11月21日，零跑汽车于广州国际车展正式揭幕全新 A 平台首款车型——零跑 A10，标志着零跑补齐 A、B、C、D 四大系列矩阵的最后一块拼图，正式进入主流细分市场全覆盖的新阶段。作为一款定位“智能精品长续航 SUV”的全球车型，零跑 A10 以“好而不贵、科技普惠”为核心理念，集 500km CLTC 超长续航、高通 8295P+8650 双旗舰芯片、车位到车位全场景智能辅助、油冷电驱、88.1%空间得房率等越享配置，为主

流家庭及追求品质的用户提供全场景不将就的出行解决方案。

(六) 通信电子

● 博通推出全球首款量子安全第八代 128G SAN 交换机产品组合

博通宣布推出博科 X8 导向器和博科 G820 56 端口交换机, 这是业界首款专为满足当今关键任务工作负载和企业级人工智能应用需求而设计的 128G 光纤通道平台。博科第八代光纤通道通过嵌入式 SAN 人工智能技术, 为量子时代提供存储安全保障, 并实现基础设施管理的自动化。

● 中兴与印尼 XLSMART 合作完成 FDD Massive MIMO AAU 产品

11 月 24 日中兴通讯与印尼领先的电信和信息通信技术运营商 XLSMART 合作, 成功完成其 FDD 大规模 MIMO 有源天线单元 (AAU) 的试验。该 AAU 支持多代全无线接入技术 (2G/4G/5G)。此次在印尼班加县进行的试验表明, 这一创新解决方案不仅确保了传统语音服务的稳定性, 还显著提升了数据服务的网络性能。试验结果显示, 用户平均数据速度提升了一倍以上, 总扇区流量增长了 20%, 从而显著改善了用户体验, 并为运营商的收入增长开辟了新的机遇。

● 诺基亚与日本 NTT DOCOMO 部署 MantaRay SON 革新 5G 运营

11 月 25 日诺基亚宣布与日本 NTT DOCOMO 合作, 在其多厂商 LTE 和 5G 无线接入网中部署自主 MantaRay SON 自组织网络解决方案。这是诺基亚 5G 基站首次与 DOCOMO 的运营系统在日本实现融合, 从而为 5G 运营带来先进的自动化和运营效率。目前部署工作正在进行中, 预计将提升 DOCOMO 的运营效率并改善客户体验。

(七) 医疗电子

● GE 医疗 23 亿美元收购 Intelrad, 加速布局云端与 AI 生态

GE Healthcare 计划以 23 亿美元现金收购影像软件开发商 Intelrad, 目标是建立一个云端优先的诊断生态系统, 该系统能够进入门诊、远距放射学和医院环境。透过将 GE HealthCare 在全球规模上的医疗设备和 AI 能力与 Intelrad 的企业云端和影像专业知识相结合, 将更有能力满足医疗服务提供者不断变化的需求、简化复杂的工作流程, 并推动整个行业的数位创新。

四、重点产品行情

(一) 存储芯片

2025 年 11 月存储芯片重点产品行情一览

产品	代表型号	价格趋势	交期（周）	供需状态
DDR4	16GB	上涨	4-39 周	紧张
	8GB	上涨	4-39 周	紧张
LPDDR4/4x	8GB	上涨	16-26 周	紧张
LPDDR5/5x	8GB	上涨	——	紧张
NAND Flash	128GB	上涨	4-24 周	紧张
	64GB	上涨	4-52 周	紧张
	32GB	上涨	6-26 周	紧张
eMMC	16GB	上涨	4-20 周	紧张
	8GB	上涨	40 周	紧张
	4GB	上涨	10-40 周	紧张
SSD	120GB	上涨	8 周	紧张

信息来源：CFM，芯存社，DigiKey

● 存储现货市场急单需求形成动力支撑，存储成品端价格继续上探

1) 产品动态

- **DDR4/LPDDR4:** DRAM 方面，DDR4 颗粒现货市场剧烈上涨，部分价格与同容量的 DDR5 倒挂，显然消费类客户难以接受如此高成本的 DDR4 产品，而当前原厂面向下游存储厂商的消费类 DDR4 颗粒供应长时间处于停滞状态，而现货价格太

过高昂，在正常补库难以为继且现有库存仍在消耗下，这种市况反而成为持续支撑行业 DDR4 内存条价格坚挺上行的强大动力。其中，DDR4 16GB 涨幅达到了 20% 左右，LPDDR4/4x 和 LPDDR5/5x 涨幅则分别高达约 46.7%、29.2%。

- **NAND Flash：**行业厂商基本遵循以优先满足 PC 大客户采购需求为重心，并且按约定推进交货进程。与此同时，经过近两个多月的涨价行情，现货市场 NAND 资源价格高悬，加上多数原厂供应迟迟未定，加剧了行业厂商对上游资源支持力度和高定价的担忧，从而更加谨慎出货。NAND 的代表型号 128GB、64GB、32GB 涨幅均在 30% 以上。
- **eMMC：**根据供应链消息，原厂释放出的 NAND ASP 已达 \$0.1/GB，现货市场价格则更高，同时近期在现货市场还出现存储厂商扫货的身影，甚至部分贸易商也不惜高价收购嵌入式 eMMC，整体贸易投机氛围持续高涨。随着资源价格不断攀升，加上全年业绩已几近完成，存储厂商嵌入式 eMMC 继续上调价格。除按已签订的协议正常交付产品以外，普遍控制接单。
- **SSD：**随着存储行情风向的快速转变，部分渠道厂商几度暂停出货和接单，叠加贸易行为的推波助澜，渠道市场价格波动更加剧烈。目前，一些渠道厂商已暂停对外公开报价，转为仅向部分主要客户单独报价，其中，渠道 SSD 面向部分消费类客户紧急订单需求给予少量供应，而内存条则优先供应整机客户。

2) 市场趋势

- **涨价核心驱动：**本轮涨价的根本动力来自 AI 服务器需求的爆发。AI 服务器对 DRAM 的用量是传统服务器的 8 倍，对 NAND 的用量也达到 3 倍，这严重挤占了原本用于手机、PC 等消费电子的产能。同时，三星、SK 海力士等国际大厂将更多产能转向利润更高的 HBM 和服务器用 DDR5，导致消费电子领域常用的 LPDDR、DDR4 等产品供应锐减。
- **供需极端失衡：**模组厂商表示，市场的供应紧张状况是 20 年来最严重的，有客户实际能拿到的货量仅为下单量的三成，陷入“有钱也买不到货”的困境。这种供需失衡在 11 月进一步加剧，甚至有手机厂商考虑通过拆解库存手机来获取存储芯片以弥补新机的供应缺口。
- **从“去库存”转向“比库存”：**CFMS 闪存市场分析师戴晓瑜向证券时报记者表示：“相比过往存储行情上涨，本轮存储涨价速度快、幅度大、品类多，特别是第四季

以来步入普涨行情，存储模组厂交期也普遍延长。”据介绍，当前国际存储原厂的供应重点都围绕北美市场服务器市场，9月以来加单到爆，导致对华供应受挤兑；即便有限的产能也会优先保障互联网大厂以及头部消费电子厂商，模组厂供货相对不足。

➤ **下游连锁反应：**存储成本的大幅上涨已传导至下游终端厂商。

手机与 PC：为应对成本压力，部分手机品牌已计划上调新机价格。PC 厂商则可能调整产品配置，未来新推出的笔记本和台式机可能会降低标配的内存和存储容量，例如从主流的 16GB+512GB 回调至 8GB+256GB。

显卡与服务器：英伟达和超威半导体均已释放显卡涨价预警。服务器厂商的成本也因存储芯片价格波动而显著上升。

(二) GPU

2025 年 11 月 GPU 重点产品行情一览

产品	代表型号	厂商	价格趋势	供需状态
消费级	GeForce RTX 50 系列	英伟达 Nvidia	上涨	平衡
	Radeon RX 9070 XT	超威半导体 AMD	下降	紧缺
数据中心	RTX PRO 6000	英伟达 Nvidia	下降	平衡
	NVIDIA 5880 Ada	英伟达 Nvidia	上涨	紧缺
	Blackwell B300 / GB300	英伟达 Nvidia	上涨	紧缺

数据来源：TweakTown，中国 IC 交易网，DigiKey，Quiksol

● GPU 需求激增，但高端产品供应持续紧张

1) 市场动态

- **显卡竞争加剧：**在德国最新周度销售榜单上，AMD Radeon RX 9070 XT 以 925 台的销量，罕见地超越了整个 NVIDIA GeForce RTX 50 系列的总和，标志着显卡市场竞争态势出现微妙转折。NVIDIA 依然占据数据中心 GPU 市场的主导地位，但 AMD 和 Intel 的持续进步尤其是在 AI 推理和大数据计算方面，正在快速缩小差距。随着市场竞争的加剧，价格可能趋于稳定，技术更新和性能提升将成为各大厂商争夺市场份额的关键。
- **价格结构性上涨：**此次 GPU 及相关硬件的涨价，根源在于 AI 产业从“探索”进入了“高渗透”阶段。AI 业务渗透率大幅提升，直接拉动了核心算力需求。这股涨价潮已从最核心的 AI GPU，蔓延到了光模块芯片、专用 AI 芯片（ASIC）等领域。例如，AMD 已因内存价格上涨通知合作伙伴，其 GPU 价格将全面上调至少 10%。机构预测，存储价格在 2025 年底前可能再上涨 30%，这会给包括 GPU 在内的整个硬件生态带来持续的成本压力。
- **AI 与高性能计算（HPC）需求激增：**AI 技术的快速发展，尤其是在深度学习和大数据处理方面，导致了对高性能 GPU 的需求急剧增加。数据中心和科研机构依赖于 GPU 来加速其计算任务，特别是在模型训练和推理方面。随着 AI 在各行业中的应用渗透，尤其是自动驾驶、医疗影像处理和金融分析等领域，GPU 的需求进一步推高。

2) 市场趋势

- **短期趋势：**今年底到明年初，GPU 市场仍受供应链瓶颈影响，价格处于上涨趋势。需求主要来自 AI 和高性能计算领域，同时游戏和虚拟现实的需求也支撑了市场。价格上涨趋势将持续，供需紧张的局面可能会延续。
- **长期趋势：**2026 年及之后随着新一代 GPU 的推出，市场竞争将加剧，厂商间的技术差异化将推动市场走向更加成熟和稳定。新产品不仅在性能上有显著提升，还会在能效、成本以及集成度上有所创新。这将推动整个市场向更高效、性价比更强的方向发展。

(三) MCU

2025 年 Q4 各厂商 MCU 交期情况

厂商	产品系列	交期（周）	交期趋势
英飞凌 Infineon	8 位 MCU	10-26	交期稳定
	32 位 MCU	10-26	交期稳定
	车规 MCU	32-45	交期稳定
微芯 Microchip	8 位 MCU	4-12	交期延长
	32 位 MCU	4-18	交期延长
恩智浦 NXP	8 位 MCU	13-39	交期稳定
	32 位 MCU	13-39	交期稳定
	车规 MCU	18-52	交期稳定
意法半导体 ST	8 位 MCU	13-33	交期延长
	32 位 MCU	13-37	交期延长
	车规 MCU	40-52	交期稳定
瑞萨 Renesas	8 位 MCU	14-18	交期稳定
	32 位 MCU	14-18	交期稳定
	车规 MCU	24	交期稳定

数据来源：富昌电子

● 车规 MCU 供不应求，本土供应链发展加速

1) 供需关系

供给紧张及交期延长：2025 年汽车与工业对 MCU 的需求回升，导致部分成熟工艺节点（主要是 40nm 及以上）产能压力大。全球主要汽车 MCU 供应商交付周期大幅延长。根据富昌电子披露信息来看，国际大厂诸如恩智浦、英飞凌、ST 等，其车规 MCU 在今年被指出“供不应求+交付周期延长”。各品牌大厂在第四季度车规 MCU 的交期最长达到了 52 周左右。

2) 产品动态

架构变革驱动高性能 MCU 需求：随着新能源汽车、电动车、多域 ECU 架构、智能座

舱、车身控制、动力系统等功能增加，对 MCU 的性能、功能安全、定制化能力提出更高要求。未来车规 MCU 除了传统控制，还越来越强调 AI/MCU 混合、模数混合 (mixed-signal)、安全认证、域控制器适配等。

3) 市场趋势

本土供应链加速发展：多家国内厂商（如芯驰科技、国芯科技、以及其他本土半导体公司）被报道正在积极开展高端车规级 MCU 设计，目标对标国际厂商，突出“车规基因+本土化+定制能力”。行业内分析预计，到 2027 年，国产车规级 MCU 的市场份额将从当前的 5%提升到 20%。供应链方面，由于多数汽车 MCU 仍依赖成熟节点和国际晶圆厂产能，若未来扩张跟不上需求，可能继续出现供不应求或交付延迟的状况。

信息来源

- [1] AP News. "Dutch government relinquishes control of Chinese-owned chipmaker Nexperia." AP News, 2025.
- [2] Arm. "Arm Announces Financial Results for the Second Quarter of Fiscal Year 2026." Arm Newsroom, Nov. 2025.
- [3] Bloomberg. "Dutch government moves to defuse tension over chipmaker Nexperia." Bloomberg, 2025.
- [4] Foxconn (Hon Hai). "Foxconn Announces Construction of 27MW GB300 Data Center in Taiwan." Foxconn Official News, Nov. 2025.
- [5] Global Times. "ChangXin Memory (CXMT) Showcases DDR5 and LPDDR5X Products at IC China 2025." Global Times, Nov. 2025.
- [6] Investing.com. "PHLX Semiconductor Index Historical Data." Investing.com, accessed Nov 25, 2025.
- [7] MarketWatch. "PHLX Semiconductor Index (SOX) Overview & Data." MarketWatch, accessed Nov 25, 2025.
- [8] Micron surges as AI ignites a new memory chip supercycle." WRAL / Financialcontent, 2025.
- [9] Nasdaq. "PHLX Semiconductor Sector (SOX) — Overview." Nasdaq Index Website, accessed 2025.
- [10] NVIDIA Achieves Full Production for Blackwell, Secures Export License for Middle East." The Wall Street Journal, Nov. 2025.
- [11] Reuters. "Dutch government suspends state intervention in chipmaker Nexperia after talks with China." Reuters, 2025.
- [12] Reuters. "Wingtech appeals Dutch decision over Nexperia ownership, documents show." Reuters, 2025.
- [13] Samsung Electronics. "Samsung Announces Price Adjustments for Memory Products and Expansion of 1c nm DRAM Capacity." Samsung Newsroom, Nov. 2025.
- [14] Schneider Electric. "Schneider Electric Secures \$2.3 Billion in Data Center Contracts for Power and Cooling Systems." Schneider Electric News, Nov. 2025.
- [15] SK Hynix. "SK Hynix Reports Q3 2025 Earnings and Provides

DRAM/NAND Price Outlook." SK Hynix Investor Relations, Nov. 2025.

[16] Supermicro. "Supermicro Unveils Full-Stack AI Solutions and Liquid Cooling Technology at SC25." Supermicro News, Nov. 2025.

[17] Swain, Gyana. "Samsung's 60% memory price hike signals higher data-center costs for enterprises." Network World, 2025.

[18] Samsung, SK hynix reportedly lift memory prices up to 30%; long-term supply deals in play." TrendForce, 2025-10-23.

[19] TradingView (via Reuters). "Dutch government suspends state intervention at chipmaker Nexperia — statement." TradingView News, 2025.

[20] TSMC. "TSMC Celebrates First Blackwell Wafer Production at Arizona Fab and Outlines 2nm Expansion Plan." TSMC News, Nov. 2025.

[21] Union Memory. "Union Memory Launches Liquid Cooling SSD for Full-Stack Liquid Cooling Servers." Union Memory News, Nov. 2025.

[22] Wall Street Journal. "AMD Reports Strong Q3 Growth Amid Insider Share Sale." The Wall Street Journal, Nov. 2025.

[23] Webull. "Philadelphia SE Semiconductor Index (SOX) Quote & Data." Webull, accessed Nov 25, 2025.

[24] Wikipedia contributors. "PHLX Semiconductor Sector." Wikipedia, last edited 2025.

[25] 美光科技. "美光：HBM3E、HBM4 明年產能全數售罄." 財報狗, 2025. DRAMeXchange, "谷歌发布第七代自研 AI 推理芯片 Ironwood", 2025.11.07

[26] statementdog, "Google 推全面導入搜尋引擎的最新 AI 模型 Gemini 3, 正面迎戰 OpenAI", 2025.11.19

[27] statementdog, "微軟、輝達攜手豪擲 150 億美元投資 Anthropic", 2025.11.21

[28] statementdog, "微軟投資逾 150 億美元於阿聯酋擴建 AI 資料中心 獲准出口輝達高階晶片", 2025.11.05

[29] 富途牛牛, "博通推出全球首款量子安全第八代 128G SAN 交换机产品组合" 2025.11.19

[30] China5e, "从西安出发, 连接全球能源未来----汇川技术 50GW 储能基地正式启航", 2025.11.25

[31] STCN, "荣耀 500 系列发布 搭载汇顶科技多项产品", 2025.11.24

[32] Eastmoney, “阿里旗下夸克 AI 眼镜将举行新品发布会 AI 眼镜行业加速发展” , 2025.11.25

[33] Samsung, “Samsung 於香港推出全球首部 Micro RGB 電視 為旗艦電視顯示技術訂立新標準” , 2025.11.21

[34] Honeywell, “霍尼韦尔八赴进博：八款新品亮相，90 载同行启新程” , 2025.11.05

[35] FinanceSina, “品牌史上动力最强量产车！2026 款保时捷卡宴纯电版发布” , 2025.11.19

[36] People, “北汽华为联手打造新款享界 S9 上市” , 2025.11.25

[37] Xinhuanet, “零跑 A10 广州车展全球首秀 10 万内首搭激光雷达” , 2025.11.22

[38] Benzinga, “ Nokia introduces MantaRay SON to NTT DOCOMO's multi-vendor 5G network” , 2025.11.24

[39] ZTE, “Implementation of ZTE All-RAT FDD Massive MIMO AAU on the XLSMART network for investment efficiency and optimization of data and voice services in the transition toward the 5G era” , 2025.11.24

[40] IBM, “23 億美元重塑醫療影像版圖!GE HealthCare 收購 Intelrad, 加速佈局雲端與 AI 生態”, 2025.11.21

[41] CFM, “现货市场急单需求形成动力支撑，多数存储成品端价格继续上探！” , 2025.11.26

[42] 存储圈, “涨幅 30%-46%，存储大厂更新合约价” , 2025.11.24

[43] CFM, “多数存储成品现货价格再度拉升，涨价潮引发的多米诺效应持续显现!” , 2025.11.18

[44] Eastmoney, “存储上下游紧急应对“超级周期” 供应链加码国产芯片” , 2025.11.27

[45] CHINA BUSINESS JOURNAL, “存储芯片价格飙涨 国内企业扩产提速” , 2025.11.24

[46] TweakTown, “NVIDIA's monster RTX PRO 6000 workstation GPU with 96GB GDDR7 drops to \$7999, down from \$10K” , 2025.11.24

[47] TweakTown, “GeForce RTX 5080 price drops below MSRP in this Black Friday Deal” , 2025.11.26

[48] 中国 IC 交易网, “ AMD RX 9070 XT 德国销量登顶，显卡市场格局悄然生

变”，2025.11.27

[49] IT之家，“行业周期性叠加 AI 需求，全球芯片市场步入 “结构性涨价” 新周期”，2025.11.25

[50] Intelmarketresearch，“MCU Market Growth Analysis, Dynamics, Key Players and Innovations, Outlook and Forecast 2025-2032”，2025.11.13

[51] Autochips，“「芯洞察」杰发科技熊险峰：MCU 市场迎黄金期，技术创新与本土化成突围关键”，2025.08.14

[52] China Society of Automotive Engineers，“第二十七届中国科协年会——汽车芯片自主创新与产业发展专题论坛召开”，2025.07.11

免责声明

安芯易电子商务（深圳）有限公司(下称“安芯易公司”)所发布的月度报告由安芯易公司市场部基于现已公开的资料、信息、研究报告等进行整理编制而成。

本报告所载的资料、意见及推测仅反映安芯易公司在报告发布当期的判断、观点，仅供学习参考之用，不构成对所述产品的出价、征价、要约或要约邀请，不构成任何合同或承诺的基础，不构成买卖任何投资工具或者达成任何交易的推荐，亦不构成任何投资、采购及其他应用建议和指导，对任何因直接或间接使用本报告涉及的信息和内容或者据此进行交易、投资所造成的一切后果或损失，安芯易公司不承担任何法律责任。因此，读者在阅读本报告时应保持警惕，并进行独立的判断和分析。

安芯易公司对本报告中所引用的资料、研究报告所涉及的或从第三方媒体获得的信息及数据的真实性、准确性、完整性和及时性不作任何明示或默示的保证。所发布的信息、观点以及数据有可能因发布日之后的情势或其他因素的变更而不再准确或失效，但安芯易公司不承担更新不准确或过时的信息、观点以及数据的义务，在对相关信息进行变更或更新时亦不会另行通知。

该报告版权归安芯易公司及相关内容提供方所有，未经授权，任何人不得以任何方式转载、修改、翻版、分发、复制、发表。

安芯易电子商务（深圳）有限公司

2025 年 11 月



安芯易隶属于Ample Solutions集团,成立于2008年,在全球拥有8个办公室,专注于为全球电子制造业客户提供元器件全球采购及供应链服务。我们始终秉持“专注、专业、坚韧、谦卑”的核心价值观,为客户提供卓越服务,助力客户成功。

我们拥有100+资深采购专家,并与来自全球的10000+供应商建立合作,致力于以更快的速度,更低的成本,为客户解决元器件供应链问题。

在深圳和香港,我们建立了两个高标准品质控制中心,严格遵循国际品质控制体系。从供应商管理到品质检测,全方位地防范风险,确保客户的元器件供应链安全和稳定。



洞察行情 精准决策

